

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的全体投资者
时间	2024 年 05 月 08 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理 于浩 独立董事 余应敏 董事会秘书兼财务总监 郑帅男
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>对公司情况、行业概况、经营情况、分红预案及战略规划进行了介绍。其中公司 2023 年度分红预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.58%。本次分红预案尚需通过公司股东大会审议通过。</p> <p>二、投资者问答</p> <p>1. 请问募投项目进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！募投项目正在如期推进中。感谢您的关注！</p>

2. 公司的主营业务是什么？未来发展重心呢？

答:尊敬的投资者，您好！公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备。公司致力于探索实践适合本企业的发展战略与实现路径，努力构建适合企业长期发展的战略任务及要素，向智能制造转型升级、提质增效，打造更具活力与韧性的产业核心竞争力。感谢您的关注！

3. 请问公司的销售模式是怎么样的？

答:尊敬的投资者，您好！公司采用直销模式销售产品，通过商务谈判或招投标等方式获取销售订单。感谢您的关注！

4. 郑老师您好： 1. 公司在研发方面与华为、上海微电子是否有合作；公司是否参与 euv 光刻机及其专用设备的开发。 2. 公司生产的温控设备、废弃处理、晶圆传片与其它友商比具有哪些技术上的优势。 3. 公司目前的估值是否偏低。 最后祝领导身体健康、万事如意。

答:尊敬的投资者您好！公司主营产品为半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备及晶圆传送设备，公司研发情况已在公司 2023 年年度报告及招股说明书等相关披露文件中披露。总体而言，公司半导体专用温控设备与主流竞品在核心技术指标方面不存在重大差异，温控范围、温控精度、冷却能力等产品关键性能参数处于国内领先、国际先进水平；公司半导体专用工艺废气处理设备与主流竞品在核心技术指标方面不存在重大差异，废气处理效率、废气处理量等产品关键性能参数处于国内领先，国际先进水平；公司晶圆传片设备与主流竞品在核心技术指标方面不存在重大差异。公司与主流竞品相关技术指标的对比详见招股说明书等披露文件。股票价格波动受宏观经济、市场环境、投资者预期等诸多因素影响，公司无法左右。感谢您的关注！

5. 请问公司业务方面有没有一些技术壁垒？

答:尊敬的投资者，您好！以公司的主营产品半导体专用温控设备为例，该设备的核心技术指标包括温控区间。随着工艺制程的发展，晶圆制造对温控设备的温控区间要求朝着超低温温控区间发展，当前包含国内外厂商在内的整体市场中能够提供超低温温控区间产品的厂家数量极少。公司已能够实现-70℃超低温温控，公司在研项目正朝着提供更低温控区间方向进行研发。潜在竞争者因缺

乏前期技术积累，进入该产品领域难以达到超低温的温控区间技术要求，其产品竞争力将受到限制，其研发产品也受到公司知识产权保护措施的影响，研发成功难度较大。感谢您对公司的关注与支持。

6. 请问公司目前有在建的工程吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司目前在建的工程为集成电路制造专用高精控制装备研发生产（安徽）基地项目。感谢您的关注！

7. 请问与同行可比公司相比，公司的核心竞争力体现在什么地方？

答:尊敬的投资者，您好！公司作为国内实现进口替代的半导体专用设备供应商，高度重视核心技术的自主研发与创新，截至2023年12月31日，公司应用于主营业务的发明专利94项，研发创新成果显著。公司目前已拥有优质、稳定的客户资源，在行业内积累了良好的产品、技术和服务口碑，与主要客户有着稳定的合作关系；公司在主要客户所在地建立了本土化的服务团队，长期驻扎客户现场，跟踪公司产品运行情况，提高售后服务的响应速度和服务水平。感谢您的关注！

8. 请问公司可能面临的风险有哪些？

答:尊敬的投资者，您好！公司在经营当中可能面临客户集中的风险以及市场竞争风险；在核心竞争力当中可能面临技术升级迭代的风险、核心研发人员流失或不足的风险以及核心技术泄密的风险。感谢您的关注！

9. 请问公司重视投资者关系管理吗？公司将如何维护中小投资者利益？

答:尊敬的投资者，您好！公司重视投资者关系管理，会通过加强信息披露、举行投资者接待活动、业绩说明会等方式，积极与投资者互动沟通，传递公司价值，增进市场认同。感谢您的关注！

10. 公司目前所处行业的前景如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，而半导体专用设备市场的发展主要受下游半导体制造市场推动，是晶圆制造所必须配备的专用生产设备，该类设备

	<p>的需求会随着晶圆制造，半导体专用设备产线建设加快和设备投资支出的增长而增长。感谢您的关注！</p> <p>11. 公司报告期内归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅增长的主要原因？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为 252.64%，总资产增加较期初增幅为 116.45%，主要系本期上市发行新股导致股本、资本公积大幅增加，营业利润增长导致未分配利润增加所致。感谢您的关注！</p> <p>12. 请问公司未来的发展战略是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 05 月 08 日